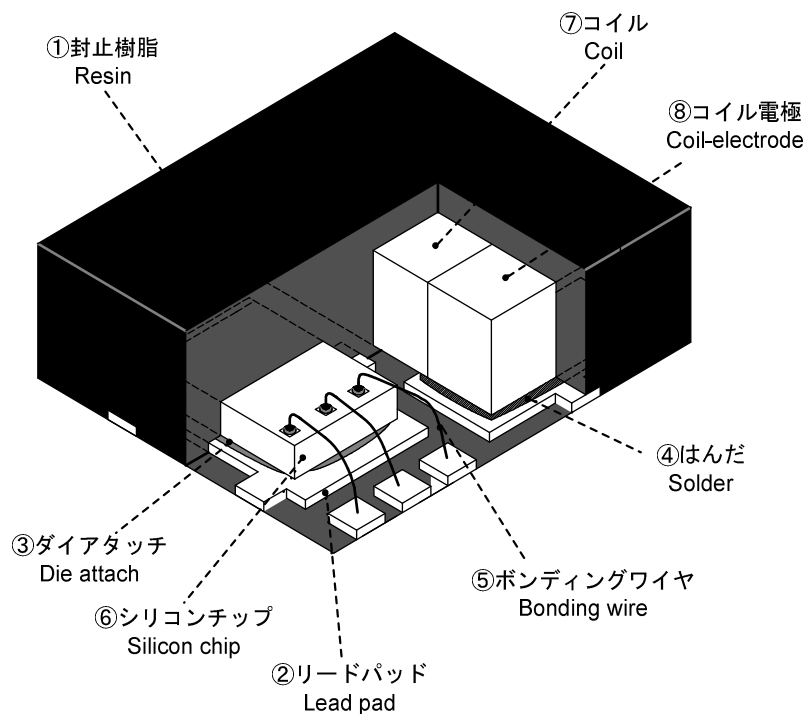


USP-9B01構造図

USP-9B01 Perspective

RoHS対応品
RoHS Compliance



| 項目 Item | 材料 Material | 備考 Note |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| ① 封止樹脂 Resin | エポキシ樹脂 Epoxy resin | 難燃グレード/Flammability rating UL94V-0 |
| ② リードパッド Lead pad | ニッケル Nickel | |
| 端子処理 Outer pad plating | Auメッキ Gold plating | |
| ③ ダイアタッチ Die attach | エポキシ Epoxy | |
| ④ はんだ Solder | 鉛フリーはんだ Pb-free solder | |
| ⑤ ボンディングワイヤ Bonding wire | Au | |
| ⑥ シリコンチップ Silicon chip | Si | |
| ⑦ コイル Coil | セラミック Ceramic | |
| ⑧ コイル電極 Coil-Electrode | Ni 下地めっき + Snめっき Ni pre-plating + Sn plating | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 捺印表示 Marking | レーザー Laser marking |
|-----------------|-----------------------|